

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2026-024

金发科技股份有限公司

关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信并进行 授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信并进行授权的议案》，现将有关事项公告如下：

为满足公司生产经营和发展的资金需要，结合公司实际情况，公司及其全资子公司、控股子公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、票据承兑与贴现、保函、信用证等。授信额度、授信期限、授信条件等以金融机构实际审批为准。

为提高工作效率，及时办理授信融资业务，单一法人主体向单一金融机构申请的授信金额不超过人民币或等值外币 50 亿元（含本数），提请董事会授权董事长在上述授信额度范围内代表公司决定相关授信事项，并签署（或签章）上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），董事长的签字与签章具有同等法律效力。董事长可在前述授信额度范围内进行内部授权。授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止。

上述授信额度不等同于公司实际融资金额，具体融资规模将根据公司运营实际需求来确定，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2026年4月21日